

无锡上机数控股份有限公司
关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度
并为全资子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 被担保人名称：弘元新材料（包头）有限公司（以下简称“弘元新材”）
- 公司及全资子公司弘元新材预计 2020 年度向银行申请合计不超过 20 亿元的综合授信额度，针对上述授信事项，公司拟为子公司弘元新材提供合计不超过 5 亿元的担保（本次预计对子公司担保事项如经股东大会审议通过后，原担保额度失效，以本次预计担保额度为准）。
- 本次担保不存在反担保。
- 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司不存在对外担保事项，也不存在对外担保逾期的情形。

一、担保情况概述

无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日分别召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于预计 2020 年度向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保的议案》，具体情况如下：

为了保证公司 2020 年资金流动性，支持公司战略发展规划，提高运行效率，降低资金成本，优化负债结构，2020 年度公司及全资子公司弘元新材预计向银行申请合计不超过人民币 20 亿元的综合授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），同时由公司为弘元新材提供不超过 5 亿元的担保（本次预计对子公司担保事项如经股东大会审议通过后，原担保额度失效，以本次预计担保额度为

准)。以上向银行申请的授信额度可以在公司及子公司之间调剂使用，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司资金的实际需求来确定。

授权公司管理层在上述额度内审核批准并签署相关文件。上述预计授信及担保事项，自股东大会决议之日起一年内有效。

本次预计担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：弘元新材料（包头）有限公司

2、注册地址：内蒙古自治区包头市青山区装备制造产业园区管委会 A 座 516 室

3、法定代表人：杨昊

4、注册资本：5 亿元人民币

5、经营范围：半导体材料、石墨材料、碳碳材料、单晶硅棒及硅片、半导体设备、太阳能设备的研发、制造、销售；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、主要财务指标：截至 2019 年 12 月 31 日，弘元新材总资产 1,429,534,486.58 元，总负债 908,911,055.38 元，净资产 520,623,431.20 元，2019 年度实现营业收入 252,700,672.91 元，净利润 19,525,656.12 元。

7、弘元新材为公司全资子公司，成立于 2019 年 5 月。

三、担保协议的主要内容

本次为预计 2020 年度担保事项，具体担保协议将在上述额度内与银行协商确定。担保协议内容以实际签署的合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次预计 2020 年度申请综合授信额度及提供担保事项，所涉及的被担保公司为公司下属控股子公司，经营状况稳定，资信状况良好，本次预计申请综合授信额度及担保事项，是为满足公司及全资子公司日常经营及发展需要，整体风险可控。同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

五、独立董事意见

公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,已制订了严格的审批权限和程序。本次申请综合授信是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作。公司能有效防范风险,决策过程遵循了公平、公正、合理的原则。本次申请银行授信额度符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度并为全资子公司提供担保事宜,并同意将该项议案提交公司年度股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为:公司本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保,是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作,公司经营状况良好,具备较强的偿债能力,本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保的事项符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司本次预计向银行申请授信并为全资子公司提供担保事宜。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司及下属子公司未发生对外担保事项。公司及下属子公司均不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

无锡上机数控股份有限公司

董 事 会

2020年3月18日